

第14回 紫外線・電子線硬化技術国際会議

日本語版

RadTech Asia 2016

Innovation Challenges with
New UV/EB Technologies

October
24-27, 2016
Tokyo,
Japan



Sponsored by
RadTech Japan

<http://radtech-asia.org/radtechasia2016.html>

プログラム

Tentative

	2016/10/24	2016/10/25	2016/10/26	2016/10/27		
9:00		Opening Ceremony	S1	S3		
		Area Overview North America	S2	G4		
10:00		Area Overview Europe	G2	G2		
		Area Overview China	Coffee break			
11:00		Coffee break	S1	G5		
		Area Overview Korea	S2	G4		
12:00		Area Overview Japan	G3	G2		
		Lunch time	G1	Lunch time		
13:00		Lunch time	Coffee break			
14:00		Keynote Dr. Amano	G3	S3	G2	
		Coffee break	G3	S3	G2	
15:00			G4	S3	G2	
16:00	S1	G1	G2	S4	Closing remarks	
17:00		G1	G2	S4	Poster session	
18:00	Get together	Banquet				
19:00						

■ 基調講演

天野 浩 教授

名古屋大学工学研究科
電子情報システム専攻電子工学分野
(2014年ノーベル物理学賞受賞)

日時：10月25日(火) 午後(予定)



■ Special Sessions

S-1 LED related technology
S-3 Printed electronics

S-2 3D printing technology
S-4 Lithography and Nanoimprint

■ General Sessions

G-1 Radiation and Photochemistry
G-2 Advanced materials and Applications
G-3 Radcure equipment, Testing, and Measurement
G-4 Functional coatings
G-5 Others (Formulations, Sustainable applications, etc)

参加登録

ウェブサイトよりご登録ください。

Category	Early Bird (until July 31, 2016)	Late & On-site
Industries	JPY 80,000	JPY 90,000
Governments and Academia	JPY 40,000	JPY 50,000
Speakers from Industries	JPY 40,000	
Speakers from Governments and Academia	JPY 30,000	
Students	JPY 10,000	

開催概要

会議名称：第14回紫外線・電子線硬化技術国際会議
RadTech Asia 2016
(The 14th International Conference on Radiation Curing in Asia)

会 期：2016年10月24日(月)～10月27日(木)

会 場：ヒルトン東京お台場(ホテル日航東京)

主 催：RadTech Asia 2016 組織委員会

共 催：RadTech Asia Organization

後 援：一般社団法人ラドテック研究会

併設展示会

会 期：2016年10月25日(火)～10月27日(木) 入場無料

開催時間：25日 9:00-17:30, 26日 9:00-17:00, 27日 9:00-15:00(予定)

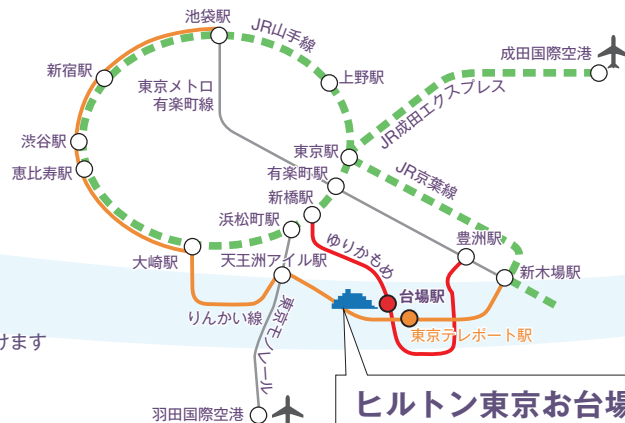
会場案内・アクセス

会 場：ヒルトン東京お台場(ホテル日航東京)
〒135-8625 東京都港区台場1-9-1
電話：03-5500-5500 / Fax：03-5500-5525

電車でのアクセス：ゆりかもめ「台場」駅直結

路線	駅	所要時間のめやす
ゆりかもめ	新橋駅～台場駅	15分
	豊洲駅～台場駅	16分

※東京テレポート駅からは徒歩約10分 / 無料シャトルバスをご利用いただけます
<http://www.hnt.co.jp/access>



お問合せ先

RadTech Asia 2016 運営事務局

株式会社JTB コミュニケーションデザイン内(旧ICSコンベンションデザイン)

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング TEL: 03-5657-0777 FAX: 03-3452-8550 E-mail: radtech16@jtbcom.co.jp